## ⑩日本国特許庁(JP)

# ◎公開特許公報(A) 平2-24848

036

Int. Cl. 3G 11 B 3

@出

願 人

G 11 B 7/26 B 29 C 43/18 B 29 K 101:10 B 29 L 17:00 識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月26日

4F

8120-5D 7639-4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5 頁)

**公発明の名称** 光記録媒体用基板の製造方法

②特 顧 昭63-173815

**20出 顧昭63(1988)7月14日** 

**6**9発明者 神 尾

優

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

**60代理人 弁理士 渡辺 徳廣** 

明 編 包

#### 1. 発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

#### 2.特許請求の義団

(1) 四凸パターンを有するスタンパー型の型面と基板の表面に光硬化性樹脂の被薬を置き、四液 減どうしが接触するようにスタンパー型と基板を 低ね合せ、加圧して被薬を点接触状態を経て面状 に拡げて密着させた後、加圧した状態で紫外線を 照射して光硬化性樹脂を硬化せしめることを特徴 とする光記線媒体用基板の製造方法。

(2) 透光性基板を介して拡板を加圧する助求項 1 記載の光記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[ 産業上の利用分野]

木発明は、光学的に情報の記録・再生を行なう 光記録媒体に用いられる基板の製造方法に関する ものである。

【 従来の技術】

 あり、追加の食を込みも可能である事から記録媒 体として有効である。

記録媒体としては、金属材料および有機色素系材料があるが、取扱い品さおよびコストの安さ 等から有機色素系材料が一般的に用いられてい

第2図は従来の光カード媒体の検式的新面図である。何図において、1は透明樹脂基板、2は光記を設定した。 3は接着層、4は保護基板、5はトラック講部である。何第2図において、情報の記録再生は、透明樹脂基板1およびトラック講部5を設め出しを行う。そして、トラック講師5の教館な凹凸を利用して・サー光の位相差によりトラッキングを行なう。

この方式では、トラック調の凹凸が情報の記録・再生の案内表を果す為、レーザービームのトラック制御精度が向上し、構無しの基板を用いる方式よりも高速アクセスが可能となる。また、トラック講の他、トラック調のアドレス、スタートピット、ストップピット、クロック信号、エラー

打正信号等のプレフォーマットを基板表面に形成 しておく事も行なわれている。

これらの方法のうち、スタンパー型を熱伝写する方法では、設備コストが高く、また成形時間が 民くかかるために生産性が良くないという欠点が ホッケ

これに対して、2Pプロセスは設備コストが低く、短期間で成形することができ、生産性に使れている点からトラック調やプレフォーマットを基板に形成する方法として最適である。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、この2Pプロセスにも以下に記す様な問題点がある。

①スタンパー要又は透明樹脂基板のいずれか一方に光硬化性樹脂の被摘を摘下して硬化するために気泡が入り易く、この気泡がトラック構やプレフォーマットが形成される層の欠陥となり光カードのトラックはずれをひきおこす原因とな

②通明樹脂基板の厚さが薄く、例えば通常2 mm以下の厚さであるために、光硬化性樹脂を硬化する数に基板がうねる。

②光硬化性視節からなるトラック湯やプレフォーマットが形成された層の厚みが不均一である。
等の欠点があった。

本発明は、上記の様な従来の光学的情報記録媒体の基板の製造に於けるトラック調やプレフェーマットの形成に用いられる2Pプロセスの問題点を克服するためになされたものであり、トラック調やプレフェーマットの形成の数に泡の発生がな

く、また基板のうねりがなく、しかもトラック機 やプレフォーマットが形成された層が均一な光記 緑蝶体用基板の製造方法を提供することを目的と するものである。

#### [設別を解決するための手段]

四ち、木兔明は、凹凸パターンを有するスタンパー型の型面と基板の裏面に光硬化性側脂の液滴を置き、 河液液どうしが接触するようにスタンパー型と基板を重ね合せ、加圧して液滴を点接触状態を軽て循状に拡げて密着させた後、加圧した状態で紫外線を照射して光硬化性樹脂を硬化せしめることを特徴とする光記録媒体用基板の製造方法である。

以下、図面に基づいて太兔明を詳細に説明す x

第1図(a) ~(c) は木売明の光記録媒体用基板の製造方法の一例を示す機略工程図である。 阿図において、 1 は透明樹脂基板、 8 は光硬化性樹脂、 7 はスタンパー点、 9 は紫外線、 6 は透光性基板、10は作製されたトラック調付き光カード基

坂である.

次いで、第1図(b) に示す様に、透光性基板6を介して透明樹脂基板1を加圧しながら、紫外線9を照射して前記光硬化性樹脂8を硬化させる。 紫外線9はスタンパー型7が不透明な場合には透明樹脂基板1側から照射し、またはスタンパー型7が透明な場合にはスタンパー型7側から照射することができる。

次に、第1図(C) に示す様に、光硬化性樹脂.8

が硬化した技スタンパー型7を取り除くと、スタンパー型の凹凸パターンが転写されたトラック調付き光カード 基板10を得ることができる。 缺光カード 基板10に形成されたトラック調の深さ、知、 抗族、ピッチ間隔等はスタンパー型7の調を切た形状に形されるため、スタンパー型7の調を抗疾よく仕上げておくことにより任金の形状をもつトラック調付き光カード基板10を上記に示す循便な方法で作成することができる。

本免明において、透明樹脂基板の裏面及びスタンパー型の型面上に調下して置く光硬化性樹脂の被調の散は1滴以上あればよく、また液滴の合計量は透明樹脂基板上へトラック調やプレフォーマット等のパターンを形成するに必要な量だけあればよく、基板の大きさにより異なるが、例えば0.81~1.0 mgが行ましい。

本発明に用いられる透明樹脂基板 1 としては、 光化学的な記録・再生において不振合の少ないも のが好ましく、平滑性が高く、記録・再生に使用 するレーザー光の透過率が高く、複屈折の小さい

材料である事が望ましい。通常、ブラスチック板やフィルムが用いられ、例えばアクリル樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ピニル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアセタール系樹脂等が用いられ、特にレーザー光通過率が良好で、かつ複屈折の少ないアクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂が好ましい。また、透明樹脂基板の厚さは通常0.1~0.5 mmの範囲の平滑な板が舒ましい。

近光性基板 6 は透明樹脂基板を保護し、うねり 及びそり等の発生を防止するために用いられる が、平滑でかつ紫外線を透過する材料が好過であ り、例えば BK7や石灰ガラス等が用いられる。

リレート系樹脂等が挙げられる。

また、木発明に使用されるスタンパー型では通常の凹凸パターンから成るスタンパー型であればよく、例えばガラス基板又は石英基板等の透光性基板にエッチング等によりトラック構やプレフォーマット等のパターンを形成したものが用いられる。

#### [作用]

従来法の2Pプロセスの様に基板で表現ではスタいのより、 で、これでは、 のの方式をでは、 のの方式をでは、 のの方式をでは、 のの方式をでは、 ののでは、 のでは、 また、木免明では近光性基板を介して基板を加圧した状態で光硬化性機能を硬化させるため、基板のうねりの発生がなく成型することができる。
【実施例】

以下、実施例を示し木発明をさらに具体的に設明する。

#### 実施例1

度 150 mm、検 150 mm、厚さ 0.4 mmのポリカーボネート 拡板 (パンライト 2 H、 帝人化成間製) 上の中央部にエポキシアクリレート (30 X 082 スリーボンド社製) からなる光硬化性樹脂を 0.3 ml 適下した。

また、接 150 mm、換 150 mm、 育さ 3 mmの組硬基 板上にエッチングにより凹凸パターンを形成した スタンパー型上の中央部にエポキシアクリレート (30 X 0 8 2 スリーボンド社製)からなる光硬化性 樹脂を 0.3 m 2 稿下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーボネート 基板を内装筒どうしが接触するように重ね合せ、 さらにポリカーボネート基板上に載150 mm。機 150 mm、 尽さ 20mmの石奘ガラス強板をのせ、プレス様で徐々に加圧後、 200 kg/ cm² の圧力で加圧しながら石奘ガラス基板を介してポリカーボネート拡板側より高圧水似灯にて紫外級(照度 140m/cm 、 距離 10cm、時間 10秒)を照射した。 次いで、石奘ガラス基板をとり除きポリカーボネート基板をスタンパー型から剝してトラック構つき透明側胎基板を製造した。

切られた透明樹脂基板は、気色の混入が特無のためにトラック講やプレフォーマットが形成された層に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無く、またトラック講が形成された光硬化性樹脂層の膜原は約10gsで均一であった。

#### 実施例 2

後150 mm, 横150 mm, 厚さ0.4 mmのポリカーボネート基板(パントライト251、 帝人化成時製)上の中央部にエポキシアクリレート(NRA201、三変レーヨン特製)からなる光硬化性樹脂を0.3 mg

また、縦150 mm。横150 mm,厚さ3 mmの石灰ガ

ラス基板上にエッチングにより凹凸パターンを形成したスタンパー型上の中央部にエポキシアクリレート (MBA201、三菱レーヨン賃製) からなる光優化性例服を0.3 ad滴下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーボネート 拡板を開被論どうしが接触するように重ね合せ、 さらにポリカーボネート基板上に接 150 mm。厚さ 20mmの石英ガラス基板をのせ、 プレス はながらスタンパー型偶より高圧水銀灯にで発力 はながらスタンパー型偶より高圧水銀灯にで発力 は、次いで、石英ガラス基板を200 kg/ cm。 がした。次がラス基板を200 kg/ cm。 がいて、石英ガラス基板を200 kg/ cm。 がらスタンパー型像より高圧水銀灯にで発射 した。次がラス基板を200 kg/ cm。 カーボネート基板をスタンパー型から割してトラック構つき透明樹脂基板を製造した。

母られた透明樹脂基板は、気私の器入が皆無のためにトラック調やプレフォーマットが形成された層に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無く、またトラック調が形成された光硬化性樹脂層の設算は約10mmで均一であった。

[発明の効果]

以上説明した様に、木晃明によれば、スタンパー型と基板の円方に光硬化性樹脂の被摘を摘下し、点接触後に加圧しながら光硬化性樹脂を硬化させるために、泡の混入がなくなり、トラック得やプレフォーマット等のパターンが欠陥なられていますれ等のないトラック視つき光記録像体用基板の製造が可能となる。

また、基板を平滑な造光性基板で加圧しながら 光硬化性機能を硬化させるために、基板のうねり やそり等の発生がなく、かつ光硬化性機能の膜厚 が均一になる。

### 4. 図面の簡単な説明

が1図(a) ~(c) は木発明の光記録媒体用基板の製造方法の一例を示す機略工程図および第2図は栄素の光カード媒体の模式的新面図である。

 1 … 透明樹脂基板
 2 … 光記録局

 3 … 接着局
 4 … 保護基板

 5 … トラック講部
 6 … 透光性基板

 7 … スタンパー型
 8 … 光硬化性樹脂

 9 … 紫外級
 10 … 光カード基板

## 特別平2-24848(5)

